

中信建投证券股份有限公司
关于北京燕东微电子股份有限公司
2024 年持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-85156450 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：侯顺	联系方式：010-65608236 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2575 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”）首次公开发行并于科创板上市。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐人与燕东微签订持续督导相关协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解燕东微经营情况，对燕东微开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报	2024 年燕东微在持续督导期间未发生按有关规定须保荐

	工作内容	持续督导情况
	告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	人公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2024 年燕东微在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐人督导燕东微及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐人督促燕东微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐人对燕东微内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，燕东微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督促燕东微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人对燕东微的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠	2024 年燕东微及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项

	工作内容	持续督导情况
	正。	
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024 年燕东微及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年，经保荐人核查，燕东微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2024 年，燕东微未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2024 年，燕东微不存在需要专项现场检查的情形
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2024 年，燕东微不存在未履行承诺的情况

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品研发与技术迭代风险

半导体行业属于技术密集型行业，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，分立器件及模拟集成电路业务新的应用场景不断涌现；晶圆制造业务代工客户需求更新迭代非常迅速，且产品品种较多；高稳定集成电路及器件技术呈现高传输速率、小型化、专用化、模块化、系统化的发展趋势；公司需要根据市场需求不断优化产品设计，升级产品制造工艺，提升产品性能和质量管控水平，及时跟进技术发展趋势。若公司技术与相关工艺未能及时推陈出新，跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，可能导致公司产品被替代，对公司的持续竞争力产生影响。

2、研发不及预期风险

公司产品及技术主要依靠自主研发，但由于半导体行业产品、技术研发往往有着难度高、周期长、投入多、不确定性高等特点，若公司现有研发项目成果不及预期，既会造成前期投入无法转换成产品，从而浪费大量人力物力，又会因没有新技术使用而使产品落后于竞争对手，从而影响经营效益。即使公司研发项目如期成功，也可能面临新技术的涌现，使已取得的研发成果无法再满足市场需求，进而影响公司可持续发展的风险。

3、关键技术人才流失的风险

半导体行业具有技术密集型的特点，对技术人才的专业性及经验要求较高。随着半导体行业快速发展，人才需求与日俱增，公司间人才竞争持续加剧，诸多半导体公司正通过授予核心技术人才股票期权、设置关键岗位为技术人才提供施展平台等方式吸引、抢夺人才。若公司不能持续提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发环境，可能会面临关键技术人员流失风险。

（二）经营风险

1、行业周期性及公司经营业绩波动风险

半导体行业具有较强的周期性特征。公司分立器件及模拟集成电路业务、晶圆制造业务、封装测试业务的终端应用以消费电子领域为主。如果消费电子等公司所处下游行业整体出现较大周期性波动，公司未能及时判断下游需求变化，或者受市场竞争格局变化、公司产能利用率走低、研发不及预期等因素影响，导致

公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司收入持续增长存在不确定性风险。

2、客户集中度较高的风险

公司客户相对集中，如果未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，可能导致公司订单下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司生产依赖于多种原材料，原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。如果未来公司主要供应商因产能紧张而大幅提升售价、推迟供货，或者由于国际政治及其他不可抗力等因素，停止向公司供货，将导致公司短期内材料供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

4、核心技术泄密风险

新产品、新工艺持续开发能力是集成电路企业的核心竞争力，经过三十余年的发展与积累，公司形成了一定数量的发明专利和非专利技术，这些技术成为公司在市场竞争中取得成功的重要依托。如果公司核心技术被竞争对手窃取或抄袭，则可能产生核心技术泄密风险，导致公司产品与方案业务及制造与服务业务的市场竞争力下降。

5、业绩下滑或亏损的风险

2024 年度公司净利润为-21,907.43 万元，较去年同期下降 151.50%。公司业绩下滑并出现亏损的主要原因系毛利率下降、研发费用上升、存货跌价准备计提增加以及政府补助减少等综合因素导致。其中受市场环境的影响，高稳定集成电路及器件业务主要产品的价格下降、销售数量下降是导致公司收入和毛利率下降的主要原因。

目前，下游市场环境正在逐步改善，公司正在丰富产品结构和客户结构，高稳定集成电路及器件业务订单已逐步增加，公司 8 英寸、12 英寸产线正在产量爬坡，公司营业收入有望回升。但若经济环境或其他因素发生变动，下游行业或主要客户发生重大不利变化，相关因素未得到改善且公司未能有效应对则可能存

在经营业绩下滑或持续亏损的风险。

（三）财务风险

1、信用风险

公司主要客户均为长期合作、信用水平较高、应收账款回款良好的企业，且公司对应收账款余额进行持续监控，但如果市场环境发生不利变化、部分客户出现经营风险而不能按时回款，公司可能存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

2、存货风险

随着公司经营规模和经营业绩的不断扩大，期末存货余额可能会随之提高，如果公司存货管理不够科学，占用公司的营运资金，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

3、利率风险

公司负债率较低，由于市场利率变动的风险与公司借款相关，所以利率风险对公司影响较小。

4、流动性风险

为了满足公司日常经营需要，公司现金及现金等价物充足，并对其进行实时监控，因此公司所承担的流动风险较低，对公司的经营和财务报表不构成重大影响。

（四）行业风险

1、行业竞争风险

在市场需求不断扩大、中国大陆产业影响力不断提升的大背景下，半导体产业整体面临着良好的行业发展机遇。但是，现有市场参与者持续扩大产能，以及新进入者的不断涌现，将进一步加剧市场竞争。如果公司不能把握市场行业发展规律、持续研发创新并提升生产管理效率，不断优化产品设计，升级产品制造工艺，可能导致公司跟不上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，产品失去竞争力，对公司业绩产生影响。

2、产业政策变化风险

半导体产业是我国的战略性新兴产业，近年来获得了国家一系列政策的大力支持。在产业政策和国民经济发展的共同推动下，我国半导体行业设计能力、生产工艺、创新水平均取得了较大的提升。如果，未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下降、产业发展速度变缓等情形，影响到公司经营。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济波动风险

公司身处半导体行业，半导体行业与宏观经济和政治环境密切相关，受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，进而影响集成电路晶圆代工企业的盈利能力；可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、汇率波动的风险

受政治、经济形势的变化以及中国外汇政策等因素的影响，人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

由于国际贸易政策存在一定的不确定性。如果全球贸易摩擦加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司经营或将受到不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，燕东微不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,704,338,864.85	2,126,903,653.81	-19.87
归属于上市公司股东的净利润	-178,115,909.79	452,292,466.72	-139.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,028,775.12	291,503,381.80	-198.81
经营活动产生的现金流量净额	318,684,153.62	402,768,425.36	-20.88
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年度末增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,677,831,705.75	14,859,119,796.56	-1.22
总资产	24,060,196,692.14	18,484,430,578.71	30.16

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.38	-139.47
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.38	-139.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.24	0.24	-200.00
加权平均净资产收益率（%）	-1.21	3.10	-4.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.95	2.00	-3.95
研发投入占营业收入的比例（%）	19.91	13.92	5.99

2024 年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、营业收入同比下降 19.87%，主要系公司产品与方案中高稳定产品销量下滑及部分消费类产品价格下滑所致；

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 139.38%，主要系公司产品与方案中高稳定产品销量下滑及部分消费类产品价格下滑导致公司净利润降低；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 198.81%，主要系公司产品与方案中高稳定产品销量下滑及部分消费类产品价格下滑导致公司净利润降低；

4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.88%，主要系经营性支出增加所致；

5、归属于上市公司股东的净资产较期初下降 1.22%，主要系本期留存收益下降所致；

6、总资产较期初增长 30.16%，主要系公司合并范围内增加控股企业，资产总额增加；

7、基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期下降 139.47%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比下降所致；

8、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 200%，主要系公司产品与方案中高稳定产品销量下滑及部分消费类产品价格下滑导致公司净利润降低。

六、核心竞争力的变化情况

（一）制造与服务能力显著增强

公司现拥有一条设计月产能为 4 万片的 65nm12 英寸生产线、一条月产能为 6 万片的 8 英寸生产线、一条月产能为 6.5 万片的 6 英寸生产线、一条月产能为 2000 片的 6 英寸 SiC 生产线。本年度，公司新开工建设 28nm12 英寸集成电路生产线，以搭建 28nm~55nm HV/MS/RF-CMOS 等特色工艺平台为目标，建成后月产能将达 5 万片。

65nm12 英寸生产线（规划产能 4 万片/月）已实现规模化量产，截至本年年底，装机产能达 3 万片/月，目前处于量产爬坡过程中，产品良率保持在 98%以上。

8 英寸生产线通过精益化管理，本年度产能从 5 万片/月提升至 6 万片/月，产品良率保持在 98%以上。

6 英寸生产线全年产能稳定在 6.5 万片/月。

公司深入推进“6+8+12”产线协同发展策略，整体制造与服务水平，取得显著提升。

（二）对创新的坚定追求

公司以增强产业整体竞争力为目标，以工艺平台和产品结构为导向，持续优化技术创新组织体系，充分发挥技术战略委员会的引领作用，启动科技创新能力评价体系建设，开展企业科技创新能力评价工作，强化以企业技术中心为创新主体的责任意识。同时，完善研发管理制度、优化部门业务流程、提升运行效率和有效配置资源。

公司始终高度重视研发投入，近三年研发投入占比持续超 10%，2024 年达到 19.91%，为技术创新注入强劲动力。同时，依托 6 英寸、8 英寸、12 英寸线，实现 600V BCD、SiN 硅光等多个工艺平台通线量产，完成 650V IGBT、100V SGT 等工艺平台搭建，并聚焦 90nm BCD、GaN 等工艺平台，积极开展关键技术攻关。同时，围绕核心技术领域加大专利布局力度，全年新增专利申请 65 件，其中发明占比超过 40%。

（三）牢固的客户关系

公司与国内多家知名企业建立了长久稳定的合作关系，搭建涵盖售前技术支持、产品推荐、售中订单跟踪、生产协同及售后保障的全流程服务体系，持续提升客户粘性和满意度。同时，围绕产品性能、交付时效等关键维度，与客户深入交流与互动，精准锚定市场需求，推动合作持续前行。

（四）深厚的产业积淀

公司自 1987 年成立以来，历经超三十五载行业耕耘，在半导体领域积累深厚底蕴，已发展成为中国大陆集成电路晶圆制造重要厂商。公司始终秉承创业创新、艰苦奋斗的产业人初心，在多年的发展过程中，铸就了一支经验丰富的专业队伍，并连续多年荣获中国半导体行业协会“中国半导体功率器件十强企业”称号，彰显了在行业中的重要地位与突出贡献。

七、研发支出变化及研发进展

（一）报告期内获得的研发成果

- 1、基于成套国产装备的 65nm 12 英寸生产线，实现从试验通线至规模量产

的转变，Trench MOSFET 等高密度功率器件具备批量稳定量产能力，产品良率达到 98.5%以上；同时，加快硅光工艺平台技术攻关，完成硅光工艺平台短流程搭建。

2、依托成套国产装备的 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，提高高附加值产品占比。其中：

（1）SiN 硅光工艺平台发布 PDK，完成多款新产品研制，实现批量稳定供货；

（2）基于超高压 BCD 工艺平台，实现多款产品规模化产出；

（3）搭建 650V IGBT 工艺平台，车规级 IGBT 产品实现稳定供货；

（4）搭建 100V SGT 工艺平台，具备批量加工能力；

（5）搭建 RF-LDMOS 功率器件工艺平台，完成 2 款射频 LDMOS 器件研制，实现千瓦级电源用射频器件的量产交付；

（6）CMOS 工业用电机驱动电路量产交付，主要性能指标得到客户认可；

（7）32 通道总线收发器产品通过客户验证并实现批量供货。

3、基于 6 英寸 SiC 生产线，持续提升工艺技术能力，其中：

（1）1200V SiC SBD 产品完成技术迭代，功率密度达到国内先进水平；

（2）1200V SiC MOSFET 完成工艺平台优化，代表产品主要性能指标得到客户认可。

（二）报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	27	16	175	93
实用新型专利	38	20	340	316
外观设计专利	0	0	0	5
软件著作权	0	0	19	18
其他	0	0	64	57

合计	65	36	598	489
----	----	----	-----	-----

（三）研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	339,413,077.59	295,971,254.94	14.68
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	339,413,077.59	295,971,254.94	14.68
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.91	13.92	增加 5.99 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	余额
募集资金净额	3,756,513,376.97
累计投入募集资金总额	3,702,454,827.45
（1）募集资金投资项目投入	1,349,705,105.18
（2）募集资金投资项目先期投入及置换	1,653,955,722.27
（3）补充流动资金	698,794,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	57,939,320.74
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	111,997,870.26
（1）募集资金专项账户期末余额	56,997,870.26
（2）用于现金管理尚未到期金额	55,000,000.00

公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具

体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

单位：万股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量
北京电控	控股股东、实际控制人	42,057.31	42,057.31	0
张劲松	董事长	0	0	0
刘锋	董事、副总经理/总经理	0	15	15
旷炎军	董事	0	15	15
金春燕	董事	0	0	0
郑浩	董事	0	0	0
龚巍巍	董事	0	0	0
范晓宁	董事	0	0	0
顾振华	董事	0	0	0
任天令	独立董事	0	0	0
韩郑生	独立董事	0	0	0
李轩	独立董事	0	0	0
周华	独立董事	0	0	0
王爱清	监事会主席	0	0	0
彭雪妮	监事	0	0	0
元巍	监事	0	0	0
李孟佳	监事	0	0	0
侯少茹	监事	0	0	0
霍凤祥	副总经理、董事会秘书	0	12	12
陈兆震	副总经理	0	12	12
滕彦斌	财务总监	0	12	12
周贺	副总经理	0	10	10
张彦秀	企业技术中心常务副主任	0	0	0

韦仕贡	企业技术中心副主任	0	0	0
周源	企业技术中心副主任	0	0	0
ZHANG XIAOLIN	技术总监	0	0	0
岳占秋（离任）	董事	0	0	0
朱保成（离任）	副董事长	0	0	0
淮永进（离任）	董事、总经理	0	0	0
李剑锋（离任）	副总经理	0	12	12
唐晓琦（离任）	副总经理	0	12	12
梁望南（离任）	董事	0	0	0
韩向晖（离任）	董事	0	0	0
刘晓玲（离任）	监事	0	0	0
曹立新（离任）	监事	0	0	0
刘娟娟（离任）	监事	0	0	0
张晖（离任）	副总经理	0	0	0
徐涛（离任）	财务总监	0	0	0

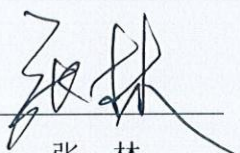
截至 2024 年 12 月 31 日，燕东微控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的不存在质押、冻结及减持情况。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


张 林


侯 顺

中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

